

【Reference Data】 FOMA UM01-HW 有害物質含有情報調査結果

NTT DOCOMO Highly Confidential
@2011 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved

本資料はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
詳細はJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 を参照いただきますようお願いいたします。

ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度が最大の部品の質量および含有濃度(ppm)を記載し、横に個数を併記しております。

- ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
- ②ダイオード、トランジスタ → 用途
- ③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただく場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約「情報の取り扱い」」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度 (ppm)	含有質量 (mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
レベルA (禁止物質)	A05	カドミウム又はその化合物	N	10	0.00032	BTB Connectorの端子	不純物		
			N	10	0.000099	RF Connectorの端子	不純物		
	A07	六価クロム化合物	N						
	A09	鉛及びその化合物	Y	600,000	0.12	チップ抵抗	成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中に含まれる鉛	
			Y	3,050	0.0168	セラミックコンデンサの中のセラミック	成分	電子部品のセラミックの中の鉛	
			Y	930,000	1.023	水晶振動子の半田	成分	高温半田の中の鉛	
			Y	30,000	1.2	水晶振動子のシェル	成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(りん青銅等)	
			Y	200	0.0052	BTB Connectorの端子	成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(りん青銅等)	
			Y	499	0.0017	RF Connectorの端子	成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(りん青銅等)	
			Y	77,493	2.2	温度補償水晶発振器	成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中に含まれる鉛	
	Y	370,000	Company Confidential & Proprietary	IC	成分	ICの中のフリップチップパンプの中に使用される半田に含まれる鉛			
A10	水銀またはその化合物	N							
A17	ビス(トリブチルスズ)＝オキシド(TBTO)	N							
A18	トリブチルスズ類(TBT類)及びトリフェニルスズ類(TPT類)	N							
B02	ポリ臭化ビフェニール類(PBB)	N							
B03	ポリ臭化ジフェニールエーテル類(PBDE)	N							
B05	ポリ塩化ビフェニル類(PCB)	N							
B06	ポリ塩化ナフタレン(塩素係数が3以上)	N							
B09	短鎖型塩化パラフィン	N							
C01	アスベスト類	N							
C02	アゾ染料・顔料	N							
C04	オゾン層破壊物質	N							
C06	放射性物質	N							
レベルB (管理)	A01	アンチモン及びその化合物	Y	25,000	0.007	抵抗の保護膜	難燃材		
			N	0.2	0.0001	トランジスタのシェル	成分		
			Y	2760	0.000072	パワーモジュールのシェル	成分		
			N	135	0.00087	SAWフィルターのシェル	成分		
	A02	ひ素及びその化合物	Y	957,500	0.4	RF Switch	成分		
			N	800	0.00067	PCBの銅箔	成分		
		Y	95,750	0.00003	パワーモジュールの半導体チップ(DIE)	成分			
	A03	ベリリウム及び化合物	N	500	0.0006	ICのボンディングワイヤ	成分		
	A04	ビスマス及びその化合物	N	272	0.00087	SAWフィルターのパッケージ樹脂	成分		
			Y	5,881	0.16	温度補償水晶発振器のシェル	成分		
	A11	ニッケル(外部利用のみ)	N						
	A13	セレン又はその化合物	N						
	B07	ポリ塩化ビニル(PVC)	N						
B08	臭素系難燃剤	Y	45,000	270	PCB ラミネート(TBBPA)	難燃材			
		Y	30,000	0.00018	PCB印刷用インク	難燃材			
		N	600	0.0006	発振器の接着剤	難燃材			
		Y	10,100	0.0076	抵抗の保護膜	難燃材			
C05	フタル酸エステル類	N							